

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成18年6月29日(2006.6.29)

【公開番号】特開2005-15506(P2005-15506A)

【公開日】平成17年1月20日(2005.1.20)

【年通号数】公開・登録公報2005-003

【出願番号】特願2003-177805(P2003-177805)

【国際特許分類】

C 09 J 163/00 (2006.01)

B 32 B 15/088 (2006.01)

B 32 B 27/00 (2006.01)

C 09 J 7/02 (2006.01)

C 09 J 163/10 (2006.01)

C 09 J 171/10 (2006.01)

【F I】

C 09 J 163/00

B 32 B 15/08 R

B 32 B 27/00 M

C 09 J 7/02 Z

C 09 J 163/10

C 09 J 171/10

【手続補正書】

【提出日】平成18年5月12日(2006.5.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】前記フェノキシ樹脂として、臭素化フェノキシ樹脂を有する請求項1記載の半導体装置用接着剤組成物。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項5】請求項1～4のいずれか記載の半導体装置用接着剤組成物からなる接着剤層と、少なくとも1層の有機絶縁性フィルムを有する半導体装置用接着剤シート。

【手続補正3】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項6】請求項1～4のいずれか記載の半導体装置用接着剤組成物を用いたカバーレイフィルム。

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

**【補正の内容】**

【請求項 7】請求項 1 ~ 4 のいずれか記載の半導体装置用接着剤組成物からなる接着剤層を介してポリイミドフィルムと銅箔とを接着してなる銅張りポリイミドフィルム。